

R5524K シリーズ 信頼性試験成績書

305524KAU -Ver. Aa

機能 : ハイサイドスイッチIC

パッケージ : DFN(PLP)1820-6 ... Au めっき、ハロゲンフリー樹脂品

(JEITA ED-4701準拠)

No.	試験項目	条件	前処理(*)	試験時間	r/n
1	高温動作	Ta=125°C VDD=Vopt max. DC印加	無	1000h	0/32
2	高温高湿バイアス	Ta=85°C RH=85% VDD=Vopt max. DC印加	①+②	1000h	0/22
3	高温保存	Ta=150°C	無	1000h	0/22
4	低温保存	Ta=-65°C	無	1000h	0/22
5	高温高湿保存	Ta=85°C RH=85%	①+②	1000h	0/22
6	温度サイクル	Ta=-65~150°C (各30分)	①+②	100cycles	0/11
7	USPCBT	Ta=125°C RH=85% 2X10 ⁵ Pa VDD=Vopt max. DC印加	①+②	100h	0/11
8	USPCT	Ta=125°C RH=85% 2X10 ⁵ Pa	①+②	100h	0/11
9	半田耐熱性①	赤外線リフロー (下図参照)	①	3回	0/88
10	半田耐熱性②	Ta=350°C (半田こて)	①	5秒	0/11
11	半田付け性①	Ta=235°C (共晶半田)	③	5秒	0/11
12	半田付け性②	Ta=245°C (半田:Sn-3.0Ag-0.5Cu)	③	5秒	0/11
13	静電耐量①	MM C=200pF R=0Ω ±200V	無	5回	0/11
14	静電耐量②	HBM C=100pF R=1.5kΩ ±2.0kV	無	3回	0/11
15	静電耐量③	CDM ±1.0kV	無	1回	0/11
16	ラッチアップ耐量	パルス電流注入法 ±100mA	無	1回	0/11

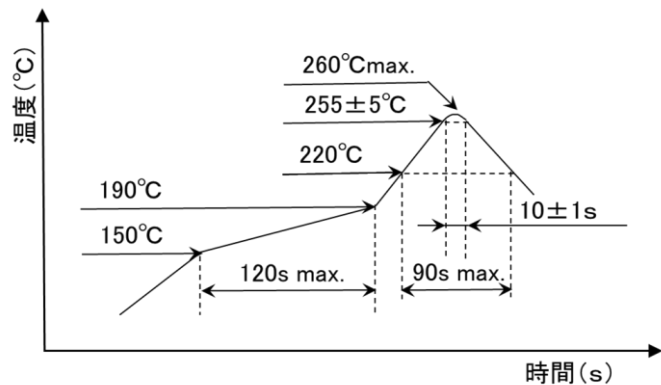
判定基準: 製品規格を満足すること。または外観に異常なきこと。

***) 前処理条件**

(JEITA ED-4701/100方法104参照)
保管時の吸湿及び実装時の熱ストレスを
各試験の前処理として行うシリーズ試験。

- ①飽和加湿処理 (Ta=85°C、RH=85%、T=168h)
- ②赤外線リフロー (連続3回実施)
- ③スチームエージング (T=4h)

鉛フリー対応リフロープロフィール(表面温度)



総合判定 : 合格

所見 : 寿命、環境試験ともに良好な結果が得られました。